



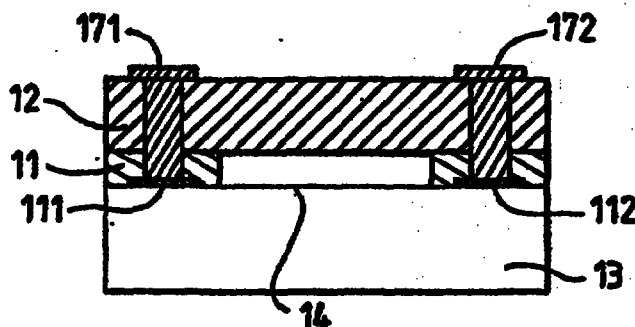
DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁷ : H03H 3/08, 9/05	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 00/35085 (43) Date de publication internationale: 15 juin 2000 (15.06.00)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/03036 (22) Date de dépôt international: 7 décembre 1999 (07.12.99) (30) Données relatives à la priorité: 98/15478 8 décembre 1998 (08.12.98) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): THOMSON-CSF [FR/FR]; 173, boulevard Haussmann, F-75008 Paris (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): BIDARD, Agnès [FR/FR]; Thomson-CSF Propriété Intellectuelle, Dépt. Brevets, 13, avenue du Président Salvador Allende, F-94117 Arcueil Cedex (FR). BUREAU, Jean-Marc [FR/FR]; Thomson-CSF Propriété Intellectuelle, Dépt. Brevets, 13, avenue du Président Salvador Allende, F-94117 Arcueil Cedex (FR). (74) Mandataire: ESSELIN, Sophie; Thomson-CSF Propriété Intellectuelle, Dépt. Brevets, 13, avenue du Prés. Salvador Allende, F-94117 Arcueil Cedex (FR).	(81) Etats désignés: CA, CN, JP, KR, SG, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>	

(54) Title: **ENCAPSULATED SURFACE WAVE COMPONENT AND COLLECTIVE METHOD FOR MAKING SAME**(54) Titre: **COMPOSANT A ONDES DE SURFACE ENCAPSULE ET PROCEDE DE FABRICATION COLLECTIVE**

(57) Abstract

The invention concerns a novel type of encapsulated surface wave components and a collective method for making such components. The component comprises a wave surface device at the substrate surface; the encapsulating case includes, besides the substrate, a first layer located on the substrate and locally hollowed at least at the surface wave device active surface, a printed circuit covering the whole of the first layer and conductive via holes running through the first layer/printed circuit assembly so as to ensure the electrical connection of the surface wave device from outside.



(57) Abrégé

L'invention concerne un nouveau type de composants à ondes de surface, encapsulés et un procédé collectif de fabrication de tels composants. Le composant comprend un dispositif à ondes de surface à la surface d'un substrat; le boîtier d'encapsulation comprend outre le substrat, une première couche située sur le substrat et évidée localement au moins au niveau de la surface active du dispositif à ondes de surface, un circuit imprimé recouvrant l'ensemble de la première couche et des vias conducteurs traversant l'ensemble première couche/circuit imprimé, de manière à assurer la connexion électrique du dispositif à ondes de surface depuis l'extérieur.